

HALBAUTOMATISCHES SELEKTIVLÖTGERÄT ONYX 29

GERÄTE

4.102

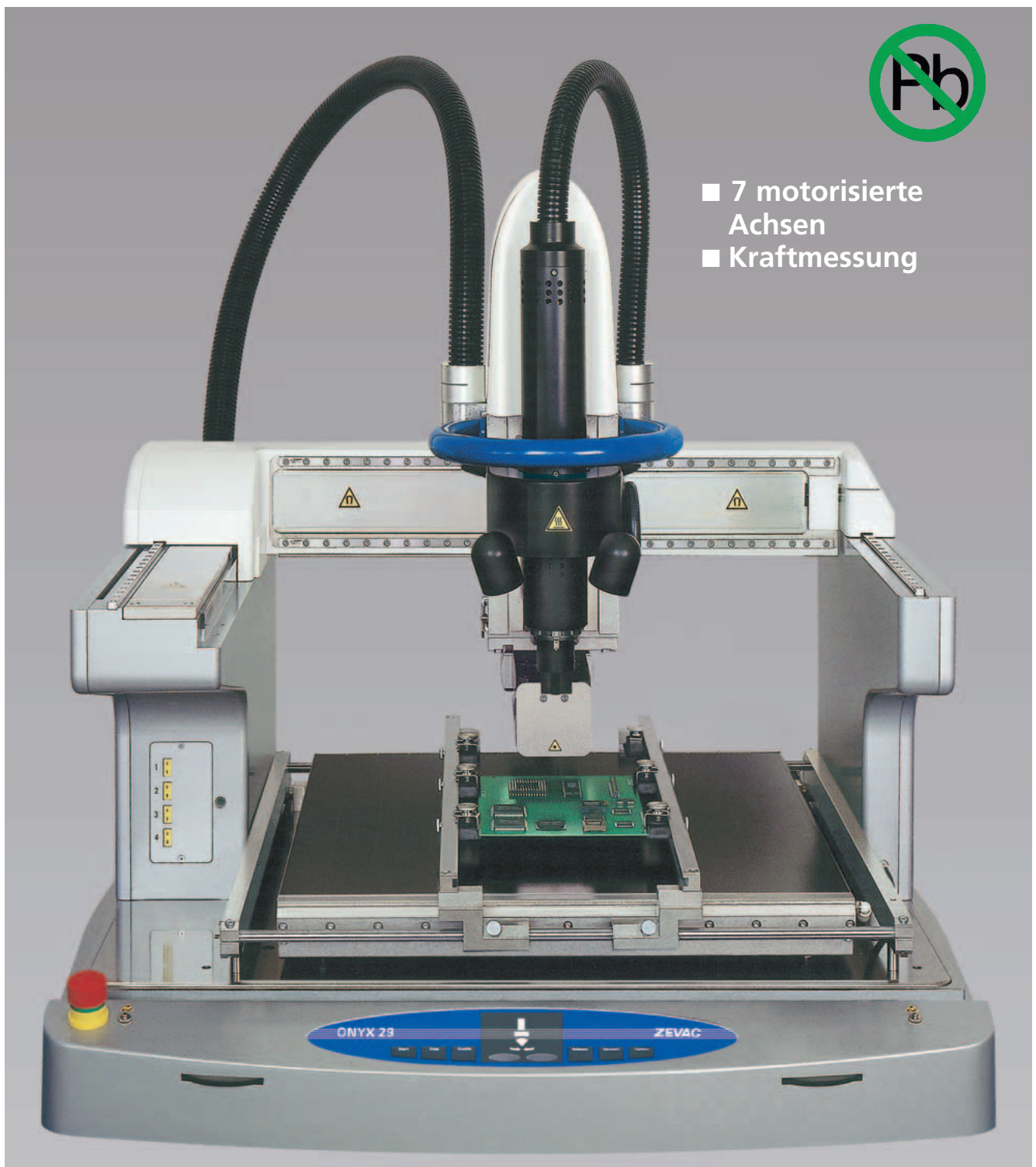


EINSATZBEREICH: SMT

ZEVAC-MODELLREIHE: ONYX

Die vollständige Dokumentation
besteht aus den folgenden

Datenblättern:

GERÄTE 4.101- 4.103**ZUBEHÖR** 2.201, 2.202**OPTIONEN** 4.301, 4.302

- 7 motorisierte Achsen
- Kraftmessung

GROSSER EINSATZBEREICH

ZUM SELEKTIVEN EIN- UND AUSLÖTEN VON SMD-BAUELEMENTEN. DAS HOCHLEISTUNGSGERÄT ONYX 29, AUSGERÜSTET MIT EINEM SPEZIELLEN VISION-SYSTEM FÜR DIE EXAKTE AUSRICHTUNG ALLER SMD- UND FINE PITCH-BAUELEMENTE, BIETET EIN HOHES MASS AN SICHERHEIT UND BEDIENUNGSKOMFORT. ES IST IDEAL FÜR:

Reparaturen

Schlecht platzierte Bauelemente können exakt positioniert, defekte Bauelemente ausgetauscht werden.

Prototypenbau

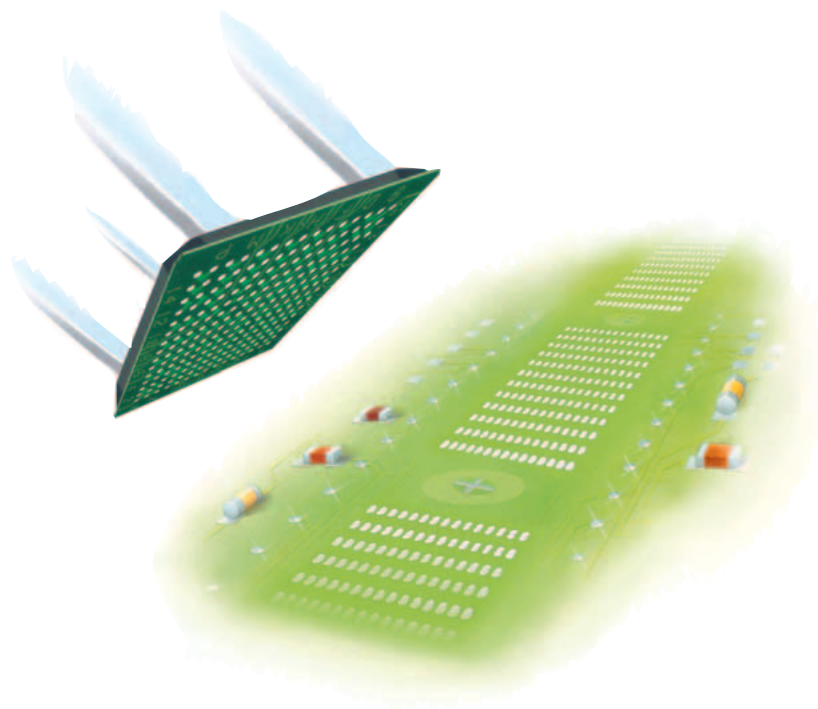
Prototypen von Leiterplatten können mit dem ONYX 29 auf rationelle Art bestückt und gelötet werden. Teure Bauelemente können wiederverwendet werden.

Nachbestückung

Bauelemente, die bei der Leiterplattenproduktion fehlen, können nachträglich bestückt oder gelötet werden. Auch einzelne Bauelemente, die mit vorhandenen Produktionsautomaten nicht verarbeitbar sind, können nachträglich bestückt oder gelötet werden.

Bestückung

Sind Leiterplatten mit nur wenigen Bauelementen zu bestücken, dann ist in vielen Fällen der Einsatz des ONYX 29 die wirtschaftlichste Lösung.



MARKTANFORDERUNGEN

DIE RASANTE ENTWICKLUNG DER SMT FORDERT FÜR DIE HANDHABUNG EINZELNER SMD's IMMER MEHR PROFESSIONALITÄT. IMMER KOMPLEXERE BAUELEMENTE MÜSSEN IMMER PRÄZISER PLATZIERT WERDEN. IMMER WERTVOLLERE LEITERPLATTEN MÜSSEN IMMER SORGFÄLTIGER BEARBEITET WERDEN. DAS ONYX 29 WIRD DIESEN ANFORDERUNGEN IN BESONDERER WEISE GERECHT.

AUTOMATISCHE PROZESSKONTROLLE

Die Prozesse zum Aufnehmen des Bauelementes, Fluxen, Aus- und Einlöten (Thermoprofile) laufen entsprechend der definierten Programmierung vollautomatisch und geregelt ab.

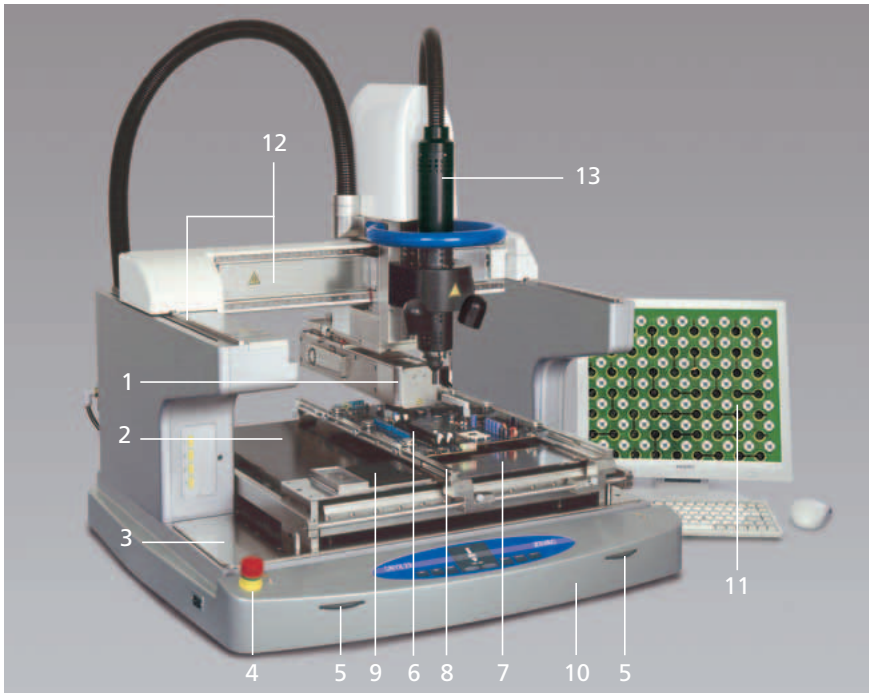
Bauelemente



Die ZEVAC-Standarddüsen der bewährten DRS24-Modellreihe können ohne Modifikationen auf der ONYX 29 eingesetzt werden.

Mit der ONYX 29 können alle SMD-Bauelemente, wie z.B.

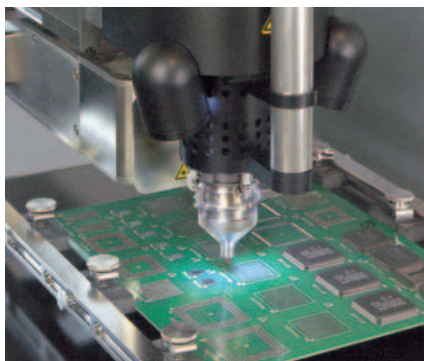
- Chips, bis zu 0201
- Flip Chip
- µBGA, CSP, BGA
- LGA, MLF
- CCGA, TCP
- QFP und Fine Pitch
- Stecker und Sockel
- RF-Abschirmungen
- kundenspezifische Bauelemente einfach und sicher verarbeitet werden.



ONYX 29:

Wiederholbare Ergebnisse durch 7 motorisierte Achsen

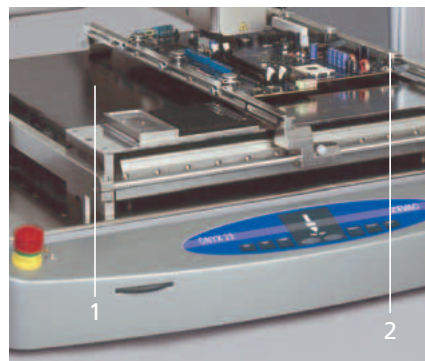
- 1 MFOV Visionsystem
- 2 4-Zonenvorwärmer 6000 W
- 3 Grundplatte mit Kraftmessung
- 4 Notstop-Taste
- 5 XY-Feinverstellung
- 6 Leiterplatte
- 7 Bauelement-Aufnahme-Platz
- 8 Leiterplattenhalter
- 9 Waffle trays
- 10 Stabiler Gussunterbau
- 11 Bildschirm
- 12 X- und Y-Linearmotoren
- 13 Heizkopf oben, 2000 W



**MULTIFUNKTIONALER HEIZKOPF
Mehrfachanwendungen**

Der gleiche Heizkopf wird für folgende Anwendungen eingesetzt:

- Löten aller SMD-Bauelemente mit Heissgas oder Stickstoff (inkl. bleifrei)
- Restlotentfernung
Mit dieser Option kann das Restlot automatisch von der Leiterplatte entfernt werden.
- Als Option ist ein Dispenser für Dosieranwendungen erhältlich.
- Kundenspezifische Anwendungen auf Anfrage.



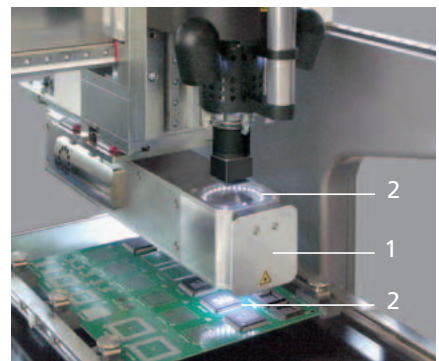
**VORWÄRMER UND PRINTHALTER
Gleichmäßiges Vorwärmen / einfache Handhabung**

Der neue, keramisch beschichtete 4-Zonenvorwärmer (4x1500W) kann einfach an unterschiedliche Leiterplattengrößen angepasst werden. Sehr gleichmäßige Vorwärmung, mechanische Unterstützungen und ein federgelagerter Printhalter garantieren ein Minimum an Leiterplattenverformung.

- 1 Vorwärmer mit 4 Zonen (je 1500W)
- 2 Printhalter

KRAFTMESSSYSTEM

Alle Bewegungen vom Lötkopf auf die Leiterplatte und Bauelement-Aufnahme werden mit einem Kraftmesssystem mit geschlossenem Regelkreis überwacht.



**VISION
Neues MFOV (multiple field of view) Visionsystem**

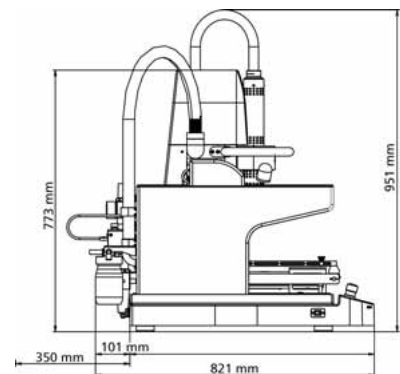
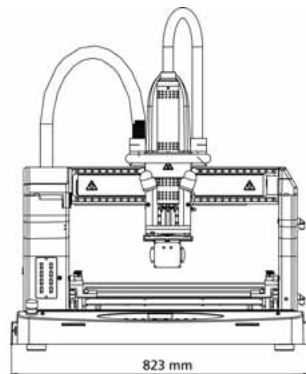
Mit dem neuen, voll motorisierten MFOV Visionsystem kann die ganze Bandbreite an SMD-Bauelementen (von 0201 bis sehr grossen BGA's mit bis zu 75mm) hochpräzise platziert werden.

Die eingebaute LED-Beleuchtung auf die Oberseite (Bauelement) und die Unterseite (Leiterplattenlayout) gewährleisten einen optimalen Kontrast für das eingebaute Kamerasystem, das für die Positionierprozesse eingesetzt wird.

- 1 MFOV Visionsystem
- 2 Einstellbare Vision-LED-Beleuchtung

Zum Visionprinzip siehe Datenblatt 2.303.

Technische Daten	Typenbezeichnung	ONYX 29
	Max. Leiterplatten-Abmessung	500 x 500 mm (länger auf Anfrage)
	Verfahrweg Roboter	400 x 400 mm
	Leiterplattenstärke	bis zu 6 mm
	Max. Bauelementhöhe	20 mm unten (30mm optional) 30 mm oben (70mm optional)
	Visionsystem Objektgrösse	0.2 x 0.2 mm - 75 x 75mm
	Bauelement- und Printbeleuchtung	einstellbare LED-Beleuchtung
	Leistung Heizkopf	2000 W
	Durchflussrate Heissgas	8 - 80 l/min (Durchfluss mit geschlossenem Regelkreis)
	Vorwärmersystem	4 unabhängige Zonen von je 1500W aktive Fläche: 490 x 490 mm
	Druckluftanschluss	4-6 bar 100 l/min
	Temperatur	20°C - 475°C
	Heissgas	Luft oder Stickstoff
	Kühlgas	Kühlluft direkt in Düse geleitet
	Steuerung	computergesteuert, Windows XP integrierte Steuerung via FireWireBus (IEEE1394)
	Anschlussspannung	3x400 / 230VAC 3PNE 50Hz 16A
	Abmessungen (L x B x H)	823 x 821 x 951 mm
	Gewicht	130kg
Technische Änderungen vorbehalten		

Prüfzeichen**Abmessungen**

Zubehör	Heissgasdüsen	Datenblatt 2.201 + 2.202
	Optionen	
	Restlotabsaugsystem	Bestellnummer 50.29.120
	Berührungsloser Prozess-Temperatursensor	Bestellnummer 50.29.100
	Zeit / Druck Dispenser	Bestellnummer 50.29.104
	Direktsicht Kamerasystem	Bestellnummer 50.29.112
	Bauelementaufnahme	Bestellnummer 50.29.116
	Leiterplatten-Kühlsystem	Bestellnummer 50.29.132
	Weitere Optionen auf Anfrage	

ZEVAC-Vertretung	ZEVAC GmbH Selektiv-Löttechnik	Telefon	089 46 16 96 3
	Bretonischer Ring 15	Fax	089 46 16 96 46
	D-85630 Grasbrunn	E-mail	info@zevac.de
		Website	www.zevac.de
ZEVAC	ZEVAC AG	Telefon	+41 / 32 626 20 80
	Vogelherdstrasse 4	Fax	+41 / 32 626 20 90
	CH- 4500 Solothurn / Schweiz	E-Mail	info@zevac.ch
		Website	www.zevac.ch